

LCP 日本住友化学 E5008L连接器专用LCP塑胶原料诚信合作

产品名称	LCP 日本住友化学 E5008L连接器专用LCP塑胶原料诚信合作
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

具有良好的耐辐射照性和化学稳定性，故常用于原子能工业密封材料和仪表零部件。它可加工成形状复杂的制品，薄而口径大的管、薄片、薄膜、电线包皮、热收缩管和化工设备衬里等。

PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作耐腐蚀件，减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件，高温电线、电缆绝缘层，防腐设备、密封材料、泵阀衬套，和化学容器。

电子电气工业的导线绝缘、电缆护套、插座、接线柱、线圈骨架、继电器、电器零部件、电容器薄膜，配电盘零件等。还可用作防腐包装材料和涂料。

塑胶原料的力学性能在长时间受热下会明显下降；

改性聚醚醚酮有黑色碳纤增强导电聚醚醚酮、红色碳纤增强导电聚醚醚酮、有矿物增强聚醚醚酮、有玻纤增强聚醚醚酮及PEEK树脂。虽然聚醚醚酮具有许多优良性能，但是价格昂贵，限制了其在一些领域的应用。另外，它的冲击强度较差，为了进一步提高其性能，以满足各个领域的综合性能和多样化需要，可采用填充、共混、交联、接枝等方法对其进行改性，以得到性能更加优异的PEEK塑料合金或PEEK复合材料。例如：PEEK与聚醚共混可得到更好的力学性能和阻燃性；PEEK与PTFE共混制成复合材料，具有突出的耐磨性，可用于制造滑动轴承、动密封环等零部件；PEEK用碳纤维等填充改性，制成增强的PEEK复合材料，可大大提高材料的硬度、刚性及尺寸的稳定性等。

一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下长期受力,会出现形变；

燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。

聚甲醛在机械制造行业用来制造机床电动机保护开关、润滑剂万向导管、磨床叶轮、外圆磨床液压套筒等。农业机械：手动喷雾器部件，播种机的连接和联运部件，挤乳机的活动部件，排灌水泵壳，进出水阀座、接头和套管等。还可用于气溶胶的包装、输送管、浸在油中的部件及标准电阻面板等。

通用塑料这类塑料是一类用途十分广泛的塑料，它产量大，约占塑料总产量的四分之三，价格低，大量用来制作受力不大的日用品，如电视机外壳、电话机外壳、塑料盆、塑料桶等。与人们的关系十分密切，成为塑料工业的重要支柱。常用的通用塑料有PE、PVC、PS、PP、PF、UF、MF等。

ADMER QF300E是一种马来酸酐接枝、均聚聚丙烯（homo PP）基胶粘剂树脂，在与PP和PA的流延膜应用中具有良好的加工性能。

热致液晶聚合物还可与多种塑料制成聚合物共混材料，这些共混材料中液晶聚合物起到玻纤增强的作用，可以大大提高材料的强度、刚性及耐热性等。

本公司品种，货源充足，产品原厂原包，，批量采购，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

用作化工防腐蚀泵的壳体、叶片、齿轮泵的齿轮、阀门、管配件及衬里、单向阀的零件、密封件的试验器皿等；

模具温度通常控制在80~100℃，对薄壁长流程

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的

聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。